

# マクダーミッド・エンソン表面処理技術セミナー 2018 AGENDA

9:00 - 9:30

受付 (平塚プレジール 5 階「高砂」)

9:30 - 9:40



## 開会のご挨拶

Julian Bashore, General Manager - Japan

9:40 - 10:05



## マクダーミッド・エンソン・テクノロジー ロードマップ

Joe D'Ambrisi, Sr. Vice President - Electronics Solutions

通訳：安藤直美

10:05 - 10:45



## 最先端ビアフィルめっき技術と硫酸銅めっき技術

Bill Bowerman, Director - Metallization

通訳：三上泰弘

10:45 - 10:55

休憩

10:55 - 11:30



## セミアディティブプロセスとICサブストレート基板 向けめっきにおける推奨製品

Jim Watkowski, Vice President, Innovation

通訳：芹澤佳世乃

11:30 - 12:00



## 最終表面処理の推移 (OSP、ENIG、錫めっき)

John Swanson, Director of OEM and Final Finishes

通訳：有吉なおみ

12:00 - 13:00

昼食 (平塚プレジール 6 階「若松」)



# マクダーミッド・エンソン表面処理技術セミナー 2018 AGENDA

13:00 - 13:30



## リジッドプリント配線基板向け ダイレクトめっきプロセス

Bill Bowerman, Director of Metallization  
通訳：山本尚孝

13:30 - 14:00



## 車載エレクトロニクスにおけるOEMの最新動向

John Swanson, Director of OEM and Final Finishes  
通訳：青木正臣

14:00 - 14:30



## カーエレクトロニクスの動向と実装技術の課題

三宅敏広(工学博士) 株式会社デンソー  
基盤ハードウェア開発部 第2ハードPF開発室 課長

14:30 - 14:50



## アルファ・アセンブリ・ソリューションズの 次世代はんだ付け材料

角田睦晴  
アルファ・アセンブリ・ソリューションズ ジャパンリサーチセンター ディレクター

14:50 - 15:00



## 閉会ご挨拶

Jim Watkowski, Vice President, Innovation  
通訳：鈴木博文

15:00 - 17:30

GDACジャパン・ラボツアー (バスで弊社ラボへご案内いたします)

17:30 - 19:30



## 懇親会 (ホテルサンライフガーデン)

(弊社ラボよりバスで会場へご案内いたします)

司会：Don Cullen, Director of Marketing Communications

スケジュール及び講演タイトル、内容は、諸事情により変更になる事がありますのでご了承願います。

●お問合せ先：  
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株式会社  
〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田480-28  
TEL0463-73-7737  
セミナー詳細及び申込書ダウンロード先：  
[www.macdermid.co.jp/seminar](http://www.macdermid.co.jp/seminar)